

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載!

## 貴金属メッキ方法と工程

\*\*\*\*\*

[登録・公開編]平成18年(1年間) 89点

(税込価格)

(本体価格)

全文PDF	CD-ROM 版(抄録版付)	¥29,085-	¥27,700-
全文紙収録	B5製本版	¥29,085-	¥27,700-
(CD-ROM版・B5製本版 一括購入)		¥43,050-	¥41,000-

### 既刊関連セットのご案内

(本体価格)

No.	登録・公開	既刊関連セットのご案内	点	本体価格
No,9920	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.17	84点 ¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点 ¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点 ¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点 ¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点 ¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点 ¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点 ¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点 ¥27,000
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点 ¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点 ¥25,300
No,7796	"	"	平.6	69点 ¥24,800
No,7672	"	"	平.5	64点 ¥23,700
No,7520	"	"	平.4	69点 ¥24,700
No,7299	"	"	平.3	66点 ¥23,000
No,7002	"	"	平.2	75点 ¥26,400
No,6723	"	"	平.1	65点 ¥22,000
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点 ¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点 ¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点 ¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点 ¥26,800
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点 ¥23,200

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	( ) Fax ( )
住所 〒	

# 貴金属メッキ方法と工程

No.10047

[登録・公開編] 平成18年(1年間) 89点

CD-ROM版 ¥29,085

B5製本版 ¥29,085

(全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥43,050 )

- |    |   |                                 |    |   |                    |
|----|---|---------------------------------|----|---|--------------------|
| 1  | 電気・電子回路部品の接続端子として用いられる複合合金金属球及びその製造方法   | 福田金属箔粉工業株式会社                    | 31 | プッシュスイッチ  | SMK株式会社            |
| 2  | 電子部品実装用フィルムキャリアテープ  | 三井金属鉱業株式会社                      | 32 | 被加工物を電気メッキするための装置及び方法                             | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー |
| 3  | 半導体パッケージ用リードフレーム  | 三星航空産業株式会社                      | 33 | 樹脂めっき方法   | トヨタ自動車株式会社         |
| 4  | 押しボタンスイッチに用いる電気接点用ばね材およびその製造方法  | 東洋精箔株式会社                        | 34 | 電気接点部材及び同接点部材の製造方法                                | SMK株式会社            |
| 5  | めっき方法   | 株式会社大和化成研究所                     | 35 | 鉄合金電子部品およびその表面処理方法                                | 株式会社シンエイ・ハイテック     |
| 6  | 難水溶性金属塩、およびその調製方法、ならびにこれを金属電着用光沢剤として使用する方法  | プラスベルク オペルフラージェンテック ゲー エム ベー ハー | 36 | 電子部品の製造方法   | 株式会社シンエイ・ハイテック     |
| 7  | 錫 - 銀合金めっき浴   | 株式会社大和化成研究所                     | 37 | フレキシブル配線板及びその表面処理方法                               | 株式会社シンエイ・ハイテック     |
| 8  | 半導体集積回路装置の製造方法  | 株式会社ルネサステクノロジ                   | 38 | 配線基板の製造方法   | 凸版印刷株式会社           |
| 9  | 銀めっきに用いるジシアノ銀酸カリウムおよびその製造方法   | 同和鉱業株式会社                        | 39 | 金めっき構造体およびこの金めっき構造体からなる燃料電池用セパレーター                | 日本高純度化学株式会社        |
| 10 | 金属を還元析出させるための水溶液  | 株式会社大和化成研究所                     | 40 | コネクタ接続端子  | 松下電工株式会社           |
| 11 | 多層配線構造の製造方法   | 株式会社半導体理工学研究センター                | 41 | めっき皮膜ステンレス鋼                                       | 松下電工株式会社           |
| 12 | 錫 - 銀合金電気めっき浴   | 大阪市                             | 42 | Sn - Ag - Cu三元合金薄膜を形成する方法                         | FCM株式会社            |
| 13 | ペースト状析出防止剤およびペースト状析出防止法   | 荏原ユーザライト株式会社                    | 43 | 配線形成方法及び装置  | 株式会社荏原製作所          |
| 14 | 電子部品のスズホイスカーの防止方法   | 石原薬品株式会社                        | 44 | 金属膜を備えた基板および金属膜の形成方法                              | 株式会社荏原製作所          |
| 15 | 金メッキ体の表面処理法及び表面処理物、金メッキ体の製造方法及び金メッキ体、並びに含硫黄分子...<br>電子実装部品用フィルムキャリアテープの電気メッキ装置及び電気メッキ方法 | 京セラ株式会社                         | 45 | 微細孔に対するメッキ方法、及びこれを用いた金バンプ形成方法及半導体装置の製造方法、並びに半導体装置 | シャープ株式会社           |
| 16 | メッキ装置及びメッキ方法  | 三井金属鉱業株式会社                      | 46 | メッキコンタクト及びコンタクトのメッキ方法                             | 日本圧着端子製造株式会社       |
| 17 | 接点と半田付け端子を有する電子部品及びその表面処理方法   | 松下電工株式会社                        | 47 | 部材の各ピンに電気メッキを施す方法及びこれに用いる電気メッキ用治具                 | 株式会社山武             |
| 18 | ハーメチックシールカバー及びその製造方法  | 田中貴金属工業株式会社                     | 48 | 貫通電極の形成方法   | キヤノン株式会社           |
| 19 | 部分メッキ装置および部分メッキ方法   | 株式会社フルヤ金属                       | 49 | 接点基板の製造方法及び電気メッキ装置                                | アルプス電気株式会社         |
| 20 | 耐食材及びその製造方法   | 株式会社フルヤ金属                       | 50 | メッキ装置およびメッキ方法                                     | 同和鉱業株式会社           |
| 21 | コネクタの製造方法並びにコネクタ  | 松下電工株式会社                        | 51 | 孔開き電解金属箔並びにキャリア基材付孔開き電解金属箔及びこれらの製造方法              | 三井金属鉱業株式会社         |
| 22 | 電解めっき装置   | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社      | 52 | Au - Sn合金のめっき皮膜                                   | 株式会社ナウケミカル         |
| 23 | めっき方法及びめっき装置  | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社      | 53 | 低磁気ヒステリシス損失の二軸配向性金属テープ及びその製造方法                    | 財団法人韓国機械研究院        |
| 24 | 複合めっき材およびその製造方法   | 同和鉱業株式会社                        | 54 | コンタクト及びそれを用いたコネクタ、並びにコンタクトの製造方法                   | 日本航空電子工業株式会社       |
| 25 | 導電性微粒子の製造方法   | 積水化学工業株式会社                      | 55 | 材料及びその用途  | ソニー株式会社            |
| 26 | 時計部品の製造方法、時計部品、および時計  | セイコーエプソン株式会社                    | 56 | 白金 - コバルト合金めっき液及びめっき方法                            | 田中貴金属工業株式会社        |
| 27 | めっき部材とその製造方法  | 有限会社ディ・エム・ラボ                    | 57 | Sn - Ag - Cu三元合金薄膜を形成する方法                         | FCM株式会社            |
| 28 | 模様付金属薄片およびその製造方法  | テフコ青森株式会社                       | 58 | メソポーラス金属膜の製造方法                                    | 学校法人早稲田大学          |
| 29 | 不溶性電極   | 田中貴金属工業株式会社                     | 59 | 金 - ニッケル系アモルファス合金めっき皮膜、電気めっき液及び電気めっき方法            | 学校法人早稲田大学          |
| 30 |   |                                 | 60 | 金めっき液および金めっき方法                                    | 国立大学法人信州大学         |

以下29点省略